

证券代码：688702

证券简称：盛科通信

## 苏州盛科通信股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	通过线上方式参与 2023 年度业绩说明会的投资者
会议时间	2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:00
会议地点	上海证券交易所上证路演中心 （网址： <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长：吕宝利 董事、总经理：SUN JIANYONG 独立董事：应展宇 副总经理、财务总监：王国华 董事会秘书：翟留镜 投资者关系：沈晓屹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所上证路演中心召开了 2023 年度业绩说明会，通过网络文字互动的方式与投资者进行了交流，具体问题及回复如下：</p> <p><b>Q1：请问公司在 2023 年营业收入的具体情况如何，较去年同期相比有何变化？</b></p> <p><b>A：尊敬的投资者，您好！2023 年公司实现营业</b></p>

收入 10.37 亿元，同比增长 35.17%，主要系公司继续积极满足客户需求，做好客户服务，产品应用进一步扩大，客户对公司品牌认可度不断提升，双方合作继续加深，实现业绩持续增长。感谢您的关注！

**Q2：公司面向大规模数据中心和云服务的 Arctic 系列研发进展如何，去年年底送样顺利不，预计何时能大规模量产，最近研发一直在增加是大多数用在 Arctic 系列，还有其他产品研发中吗？**

A：尊敬的投资者，您好！公司的高端旗舰芯片已按计划于 2023 年底给客户送样测试。对于这种大芯片，行业规律是客户从拿到这个芯片到客户产品的小批量试产，大约要一年左右的时间，从小批量试产到规模发货可能还要 6-8 个月时间。具体项目进度每个客户会略有差别。

公司近期新增的研发费用主要是用于更多新产品的开发，公司希望通过加速丰富及完善自身产品矩阵，在网络基础设施层面进一步支撑和服务我国相关产业的发展。感谢您的关注！

**Q3：请问吕总，贵司 800G 芯片的研发量产进度如何？**

A：尊敬的投资者，您好！公司的高端旗舰芯片已按计划于 2023 年底给客户送样测试，该产品支持最大端口速率 800G。对于这种大芯片，行业规律是客户从拿到这个芯片到客户产品的小批量试产，大约要一年左右的时间，从小批量试产到规模发货可能还要 6-8 个月时间。具体项目进度每个客户会略有差别。感谢您的关注！

**Q4：公司年报提到扭亏为盈的时点可能出现延缓，目前根据公司预计什么时候能够实现盈利？**

A：尊敬的投资者，您好！公司所在的通信产业目前仍然在健康快速发展，对基础网络互联的需求仍然比较旺盛。为积极响应市场及客户需求，公司加大研发投入力度，积极推进新产品的研发，丰富产品矩阵，以更坚实的产品基础支撑长远健康发展，但高强度的研发投入可能会导致扭亏为盈时点出现延缓。与此同时，公司也时刻保持对健康财务状况的关注，将以务实、认真、负责的态度，做好公司的各项经营管理，争取能够为产业界提供更优良的产品与服务支撑，以高质量的公司发展，回报市场和广大的投资者。具体盈利情况等数据，请关注后续公司的各项公告。

**Q5：公司 2023 年存货高企，主要是是什么原因，是否担心跌价或其他风险？**

A：尊敬的投资者，您好！报告期内，应下游客户要求，公司与下游客户、上游供应商建立了更为稳定的长期订单机制。公司 2023 年末存货金额为 71,625.61 万元，较上年同期增长 154.61%，占期末总资产比重为 22.78%。公司期末存货金额持续增加，主要系随着销售规模的扩大、产品市场需求量的增加以及受全球半导体供应形势的影响导致上游产能供应的不确定性增加，公司为满足销售要求并及时响应客户需求而增加备货所致。公司高度关注存货的安全性，会结合市场需求情况定期对公司存货情况及产品预定情况进行分析，确保存货结构的合理性。感谢您的关注！

**Q6：你好，2 个问题请问一下：**

	<p>1、盛科 Arctic 系列芯片，号称 24 年推出，请问目前项目是什么进度（投片、回片、测试完成？），具体 24 年什么时间推出？另外该系列芯片目前国内外是否有交换机厂商比如华为/H3C/锐捷/其他白牌厂商在同步进行产品开发？</p> <p>2、公司 23 年第 4 季度收入&lt;1.9 亿，比 1-3 季度单季度收入都低，是什么原因？</p> <p>A: 尊敬的投资者，您好！</p> <p>1、公司的高端芯片已按计划于 2023 年底给客户送样测试。对于这种大芯片，行业规律是客户从拿到这个芯片到客户产品的小批量试产，大约要一年左右的时间，从小批量试产到规模发货可能还要 6-8 个月时间。具体项目进度每个客户会略有差别。</p> <p>2、受国际经济环境及行业供应形势的影响，部分客户在 2023 年上半年加大了提货力度，导致 2023 年第一季度与第二季度的营业收入波动性抬高，相应的，第三季度和第四季度的营业收入有一定程度的回落。随着公司与产业链上下游建立长期订单机制，并通过持续、稳定的交付保障客户的信心，2024 年起异常波动已逐步消除。</p> <p>感谢您的支持和关注！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应当披露重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 4 月 26 日</p>